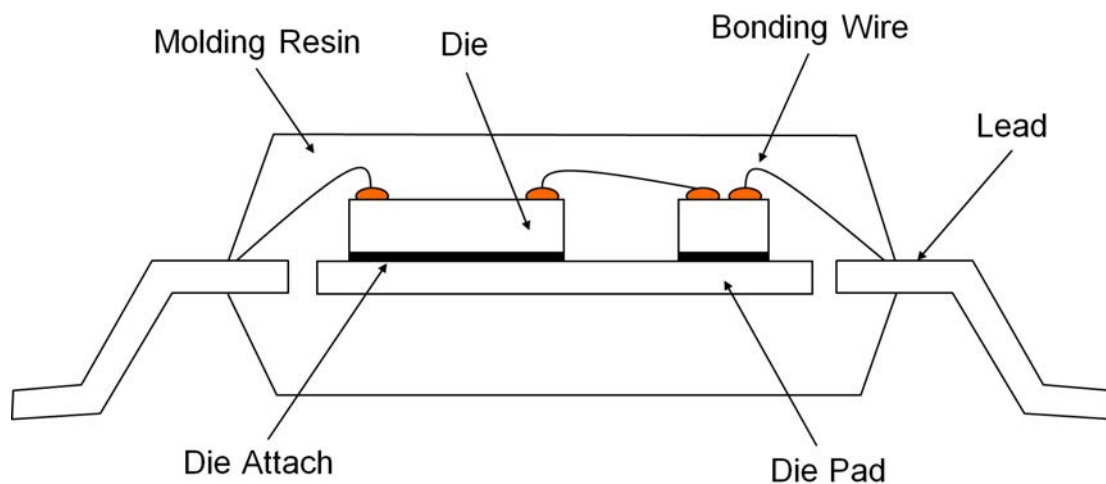


1. Package Information

Package Name	SSOP-A20_16A
Type	SOP
Pin Count	16
Package Weight [g]	0.21
Lead Finish	Pure Tin
MSL	Level3

2. Package Structure



3. Packing Specification

3.1 Packing form, Quantity, PIN1 Orientation

Packing Form		Tape&Reel
Packing Quantity	[pcs]	2,000
PIN 1 Orientation		E2

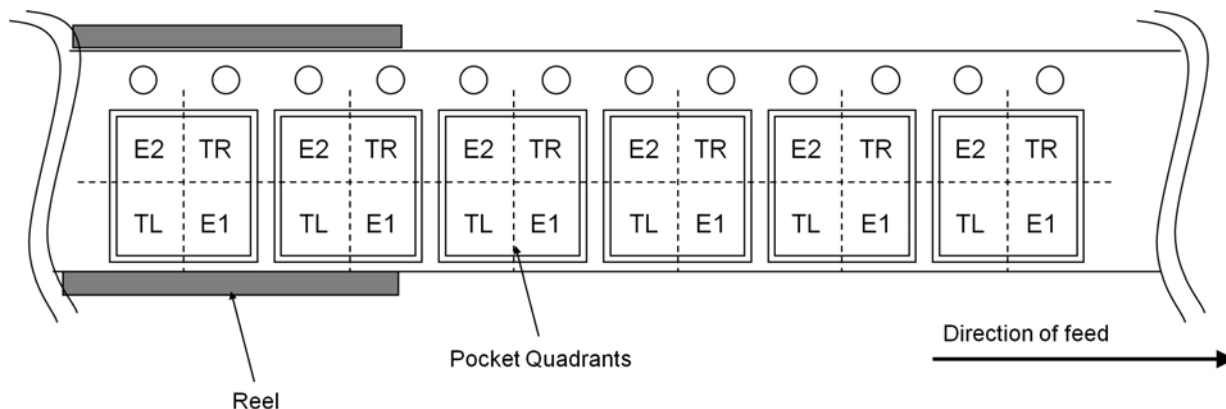


Fig.1 Quadrant Assignments for PIN 1 Orientation in Tape

E2 : PIN1 is placed to the top left corner.

TR : PIN1 is placed to the top right corner.

TL : PIN1 is placed to the lower left.

E1 : PIN1 is placed to the lower right.

3.2 Use material

Item	Material
Embossed carrier tape	PS
Cover tape	PET+PE
Reel	PS
Desiccant	Clay
Envelope	Aluminum-laminated
Air cap	PE
Unit box	Cardboard
Shipping box	Cardboard

3.3 Leader specification

No component pockets are 720 mm or more.

3.4 Trailer specification

No component pockets are 720 mm or more. Tape is free from reel.

3.5 Peelback strength

Cover tape peelback strength is 0.2 N to 0.7 N.

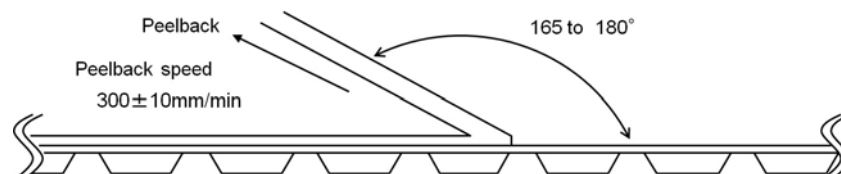


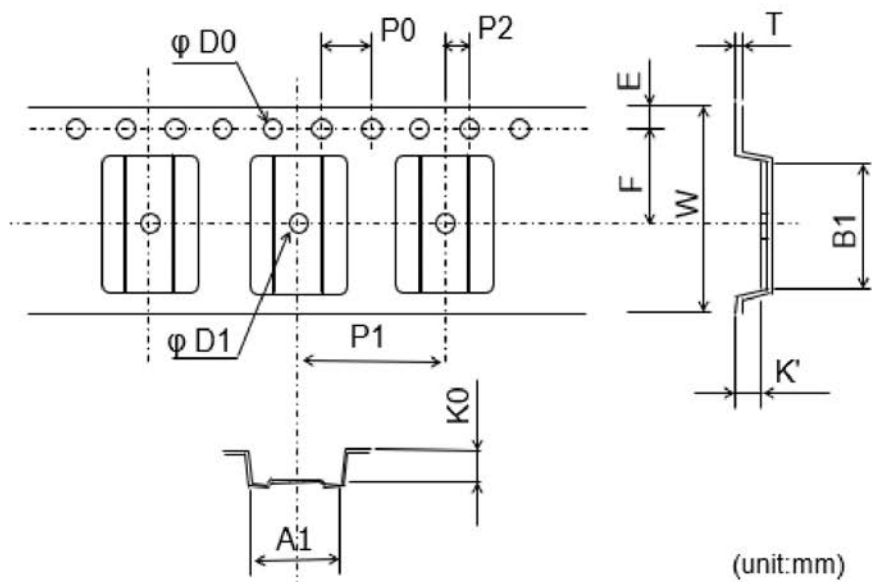
Fig. 2 Test method

3.6 Missing lcs

(1) No consecutive dropouts.

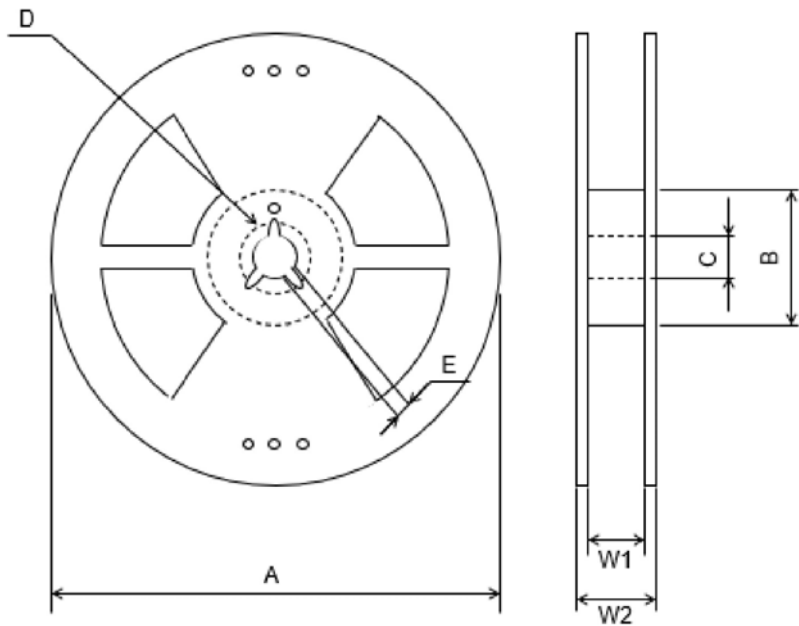
(2) A maximum 0.1 % of specified number of products in each packing may be missing.

3.7 Tape and Reel Specification
3.7.1 Tape Dimension



	Tape Dimension	Tape Tolerance
A1	8.40	± 0.1
B1	9.30	± 0.1
D0	$\phi 1.55$	± 0.05
D1	$\phi 1.55$	± 0.05
E	1.75	± 0.1
F	7.50	± 0.1
K'	2.10	± 0.1
K0	2.50	± 0.1
P0	4.00	± 0.1
P1	12.0	± 0.1
P2	2.00	± 0.1
T	0.30	± 0.05
W	16.0	± 0.3

3.7.2 Reel Dimension

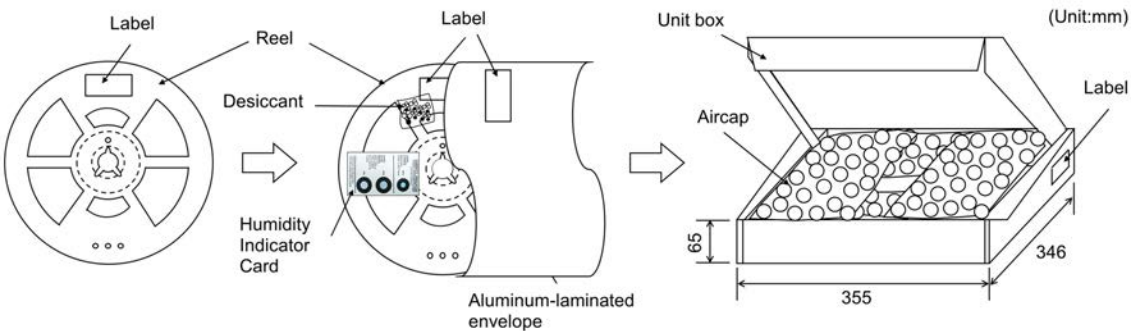


(unit:mm)

Reel Dimension		Reel Tolerance
A	330	±2.0
B	100	±1.0
C	13	±0.2
D	21	±0.8
E	2	±0.5
W1	17.5	±1.0
W2	21.5	±1.0

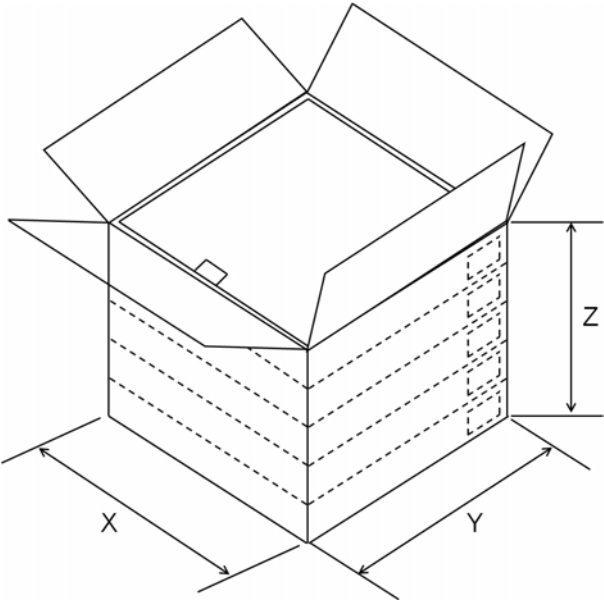
3.8 Packing Method

1 reel(s) or less per unit box



3.9 Packing Style

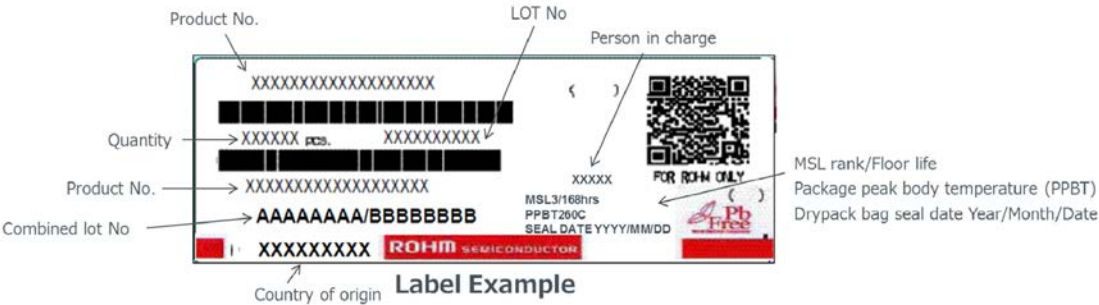
5 unit boxes or less per shipping box



(unit:mm)

Shipping Box Dimension	
X	371
Y	370
Z	307

3.10 Label Specification



3.11 Caution card specification

MOISTURE-SENSITIVE DEVICES

注意

1. ドライバック包装の保管期限は、12 ヶ月（40℃/90%RH未満）です。
2. 本製品の耐熱温度は、260℃ です。
3. 袋開封後は、下記a)b)条件下で、お使いください。
 - a) 168 時間以内（30℃/60%RH以下）にご使用ください。
 - b) 10%RH以下で保管して下さい。
4. 以下の条件の場合は、耐熱容器に入れて実装前にベークしてください。
 - a) 23±5℃の環境下でインジケータカードの 10%を超えた場合
 - b) 3a、3bの条件に合致しない場合
5. ベーク条件は、125±5℃で48時間です。

CAUTION

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months at <40℃ / 90% RH
2. Peak package body temperature: 260℃
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must
 - a) Mounted within: 168 hours of factory conditions ≤30℃/60%RH
 - b) stored at <10% RH
4. Devices require bake with heat-resistant container, before mounting, if:
 - a) Humidity Indicator Card is > 10% when read at 23±5℃
 - b) 3a or 3b not met.
5. If baking is required, devices may be baked for 48 hours at 125±5℃

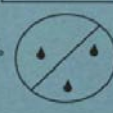
Note: If device containers cannot be subjected to high temperature or shorter bake times are desired, reference IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure

包装日：品名ラベルをご確認ください
Bag Seal Date: See adjacent bar code label

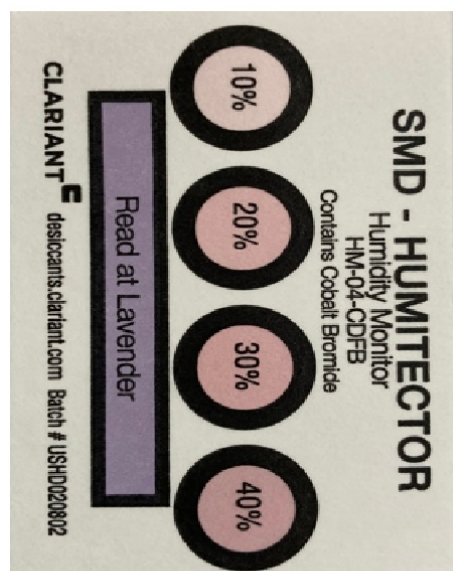
* C L 3 2 6 0 *

Note: Level and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020

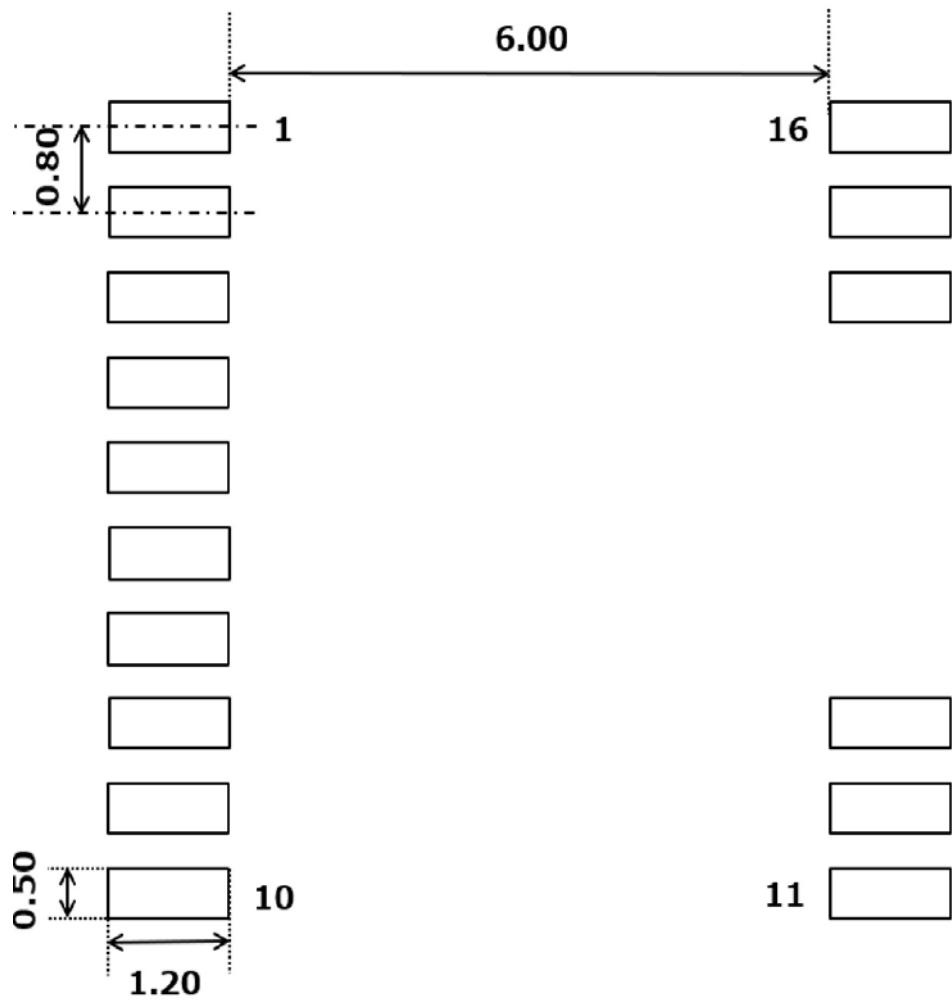
LEVEL
3



3.12 Indicator card specification



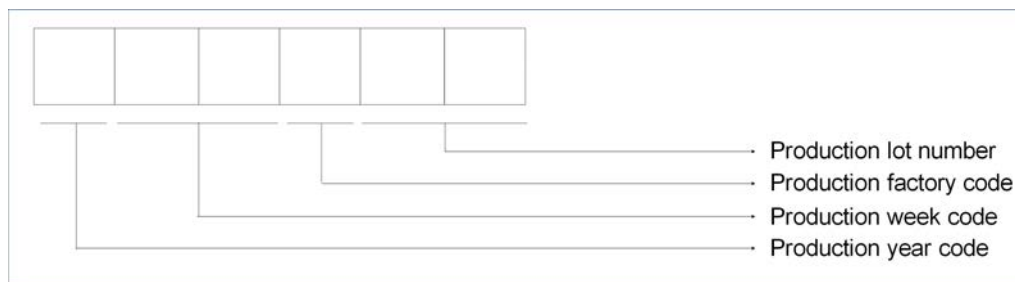
4. Footprint dimensions



(unit:mm)

In actual design, please optimize in accordance with the situation of your board design and soldering condition.

5. Marking Specification



6. Storage conditions

6.1 Storage environment

Recommended storage conditions

	Min.	Max.	Unit
Temperature	5	30	°C
Humidity	-	70	% RH

6.2 Storage period (Start to count since delivery date)

	Min.	Max.	Unit
Storage period	-	1	year

6.3 Specified storage period until soldering

	Min.	Max.	Unit
Acceptable time	-	168	h

The above value is a time from opening the moisture-proof packaging until the soldering. Cases where it is necessary to perform the drying process is the following.

Case 1 : in excess of the above-mentioned "Acceptable time"

Case 2 : it has passed more than 1 year not open

Recommended the dry process conditions

	Temperature [°C]	Time [h]
Reel (Note1)	60	48
Other Heat-proof container	125	24

(Note1) When carrying out the dry process in a "Reel" state, the peelback strength will change. Please refer to the following values:

	Min.	Max.	Unit
Peelback strength	0.2	0.9	N

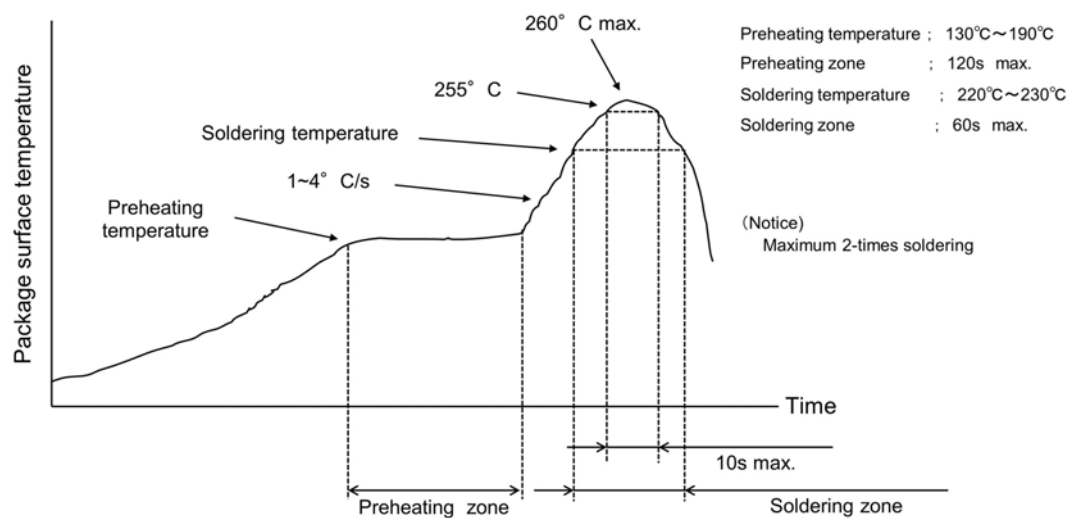
The drying process is the impact on the solderability because the oxidation of the terminal portion will occur. Therefore, specify the maximum times of the dry processing as follows:

Recommended execution count of the dry process

	Min.	Max.	Unit
Reel		1	times
Other Heat-proof container		2	times

7. Soldering conditions

7.1 Recommended temperature profile for reflow



7.2 Recommended condition for wave soldering

Preheating temperature	:	120 °C to 150 °C
Preheating time	:	60 s MAX
Soldering temperature	:	260 °C ± 3 °C
Soldering time	:	12 s MAX

Notes for wave soldering

- (1) Soldering time is provided for total soldering time in case of dual wave soldering.
- (2) Do not use other soldering methods with wave soldering.
- (3) Recommend to clean the board to eliminate flux, solder waste, and other impurities for reliability, after soldering.
- (4) Optimize soldering condition to prevent solder bridging.

7.3 Recommended condition for solder iron

Solder iron temperature	:	380 °C or less
Mounting time	:	4 s or less

Notes for solder iron

- (1) Solder mounting time is the time per 1 lead

ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。
お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>